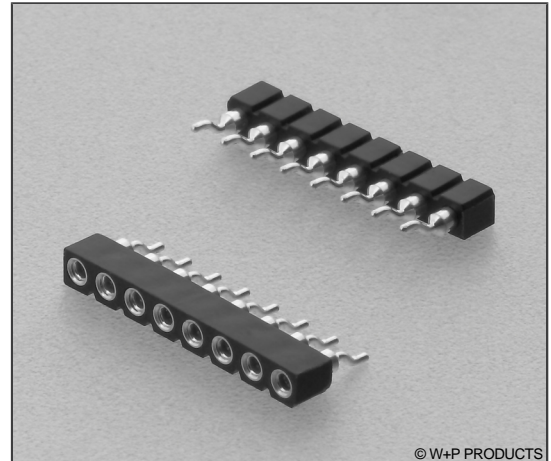


## SMT-Präzisions-Buchsenleisten RM 2,54mm, liegend, 1-reihig SMT Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Horizontal, Single Row

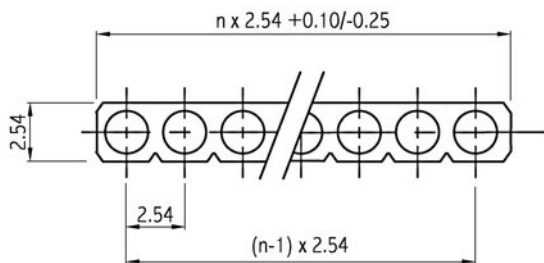
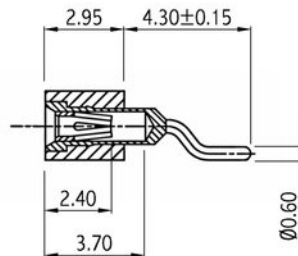
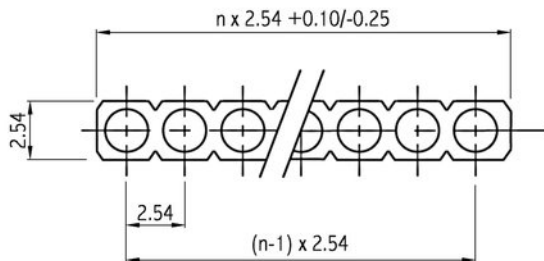
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht
Contact Material	Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
	Sleeve: screw machined brass
	Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	1 kV RMS
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering

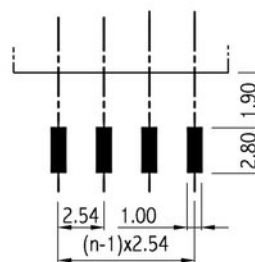


© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Rundstifte Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,40x0,25mm erhältlich.  
Accept round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins.  
Also available on request for Ø0.40-0.56mm round pins or 0.40x0.25mm rectangular pins.



### Recommended PCB Layout



Series **1535** — Contacts\* **007** — Sleeve Plating **50** — Clip Plating\* **00** — Packaging\* **ST** — Insulator\* **..**

003-050

50 Hülse verzinkt  
Tin plated sleeve

00 Feder vergoldet  
Gold plated clip  
10 Feder 0,25µm Gold (Option)  
0.25µm gold plated clip (Option)  
30 Feder 0,75µm Gold  
0.75µm gold plated clip  
50 Feder verzinkt 5,0µm  
5µm tin plated clip

ST  
TR

[ ] Beidseitig gerillter ISK (Standard)  
Grooves on both sides (Standard)  
F Oberseite glatt  
Flat Top

\* Dies ist ein Bestellbeispiel - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an order example - please replace by your specifications.

### Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen / In tubes  
TR Tape&Reel / Tape&Reel

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

